



PANEL THERMOCHIP

PANEL THERMOCHIP	e total (mm)	RT (m2K/W)	U (W/m2K)	Peso (kg/m2)	Peso (kg/panel)	*3 apoyos L=1500	
						Carga max. (kg/m2)	Carga a L=200 (kg/m2)
TOH/10-40-19_XPS 40mm	69,00	1,46	0,69	18,38	30,33	883,00	211,00
TOH/10-50-19_XPS 50mm	79,00	1,76	0,57	18,70	30,86	1000,00	239,00
TOH/10-60-19_XPS 60mm	89,00	1,96	0,51	19,02	31,38	1181,00	283,00
TOH/10-80-19_XPS 80mm	109,00	2,53	0,39	19,66	32,44	1406,00	338,00
TOH/10-100-19_XPS 100mm	129,00	2,95	0,34	20,30	33,50	1670,00	400,00
TOH/10-120-19_XPS 120mm	149,00	3,67	0,27	20,94	34,55	1805,00	434,00
TOH/10-140-19_XPS 140mm	169,00	4,25	0,24	21,58	35,61	1942,00	468,00
TOH/10-160-19_XPS 160mm	189,00	4,82	0,21	22,22	36,66	>1942,00	>468,00
TOH/10-200-19_XPS 200mm	229,00	5,65	0,18	23,50	38,78	>1942,00	>468,00

*Resistencia mecánica, cargas positivas en apoyos. L en mm

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Tablero exterior - Aglomerado hidrófugo

Espesor	e (mm)	19
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,13
Densidad	D (kg/m3)	600
Difusión al vapor de agua	μ	20
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1700

Núcleo aislante - XPS

Espesor	e (mm)	40	50	60	80	100	120	140	160	200
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,033	0,033	0,035	0,035	0,037	0,035	0,035	0,035	0,037
Densidad	D (kg/m3)	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Difusión al vapor de agua	μ	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1.450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450

Tablero interior - OSB3

Espesor	e (mm)	10
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,1
Densidad	D (kg/m3)	570
Difusión al vapor de agua	μ	13
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1700